

中英制基本单位换算

1kg=2.205lb(磅)	1 磅=0.454kg	1 英尺 =12 英寸
1OZ(盎 司)=28.3527g	1g=0.03527OZ	1 英寸 inch=1000 密尔 mil
1ft(英 尺)=0.3048m	1m=3.281ft	1mil=1000u (uinmil)
1 码=0.914m	1m=1.094 码	1OZ=28.35 克/平方英尺 =35 微米
1in(英 寸)=25.4mm	1mm=0.03937in	1in=1000mil=25.4mm,1mil=25.4um
1m ² =10.76ft ²	1ft ² =0.0929m ²	1ASD=1 安培 /平方分米 =10.76 安培 /平方英尺
1 磅力 =4.4484牛 顿	1N=0.2248 磅力	1 加仑美制 =3.785 升
1psi=0.06895bar	1bar=14.5psi=1.013kg/cm ²	1bar=100000Pa
1 马力=0.746 千 瓦		1 品脱 =568ml
1°C=1.8x°C+32°F	1°F=(°F-32)/1.8°C	1 英尺 =30.5cm

基本英文词汇

流程

Boardcut	开料	Carbonprinting	碳油印刷
Innerdryfilm	内层干膜	Peelablebluemask	蓝胶
Inneretching	内层蚀刻		
ENIG(Electrolessnickelimmersiongold)			沉镍金
Innerdryfilmstripping	内层干膜退膜	HAL(hotairleveling)	喷锡
AOI (AutomaticOpticalInspection)	自动光学检测		
OSP (Organicsolderabilitypreservative)			有机保焊
Pressing	压板	Punching	啤板
Drilling	钻孔	Profiling	外形加工
Desmear	除胶渣，去钻污	E-Test	电性测试
PTH	镀通孔，沉铜		FQC(finalqualitycontrol) 最终
品质控制			
Panelplating	整板电镀	FQA(Finalqualityaudit)	最终品质保证
Outerdryfilm	外层干膜	Packing	包装
Etching	蚀刻	IPQA(In-processqualityaudit)	流程 QA
Tinstripping	退锡	IPQC(In-processqualitycontrol)	流程 QC
EQC (QCafteretching)		蚀检 QC	
IQC(Incomingqualitycontrol)		来料检查	
Soldermask	感阻	MRB(materialreviewboard)	材料评审委员会
Componentmark	字符	QA(Qualityassurance)	品质保证
PhysicalLaboratory	物理实验室	QC(Qualitycontrol)	品质控制
ChemistryLaboratory	化学实验室	Documentcontrolcenter	文件控制中心
2 nd Drilling	二钻	Routing	锣板，铣板

精心整理

Brownoxidation	棕化	Wastewatertreatment	污水处理
V-cut	V 坑	WIP (workinprocess)	半成品
Store/stock	仓库	F.G(Finishedgoods)	成品

概述

PrintedCircuitBoard	印制电路板	FlexiblePrintedCircuit,FPC?	软板
Double-SidePrintedBoard	双面板		
IPC (TheInstituteforInterconnectingandPackingElectronicCircuits)	电子电路互连与封装协会		
CPAR (Corrective&PreventiveActionRequest)	要求纠正预防措施		
FlammabilityRate	燃性等级	Characteristicimpedance	特性阻抗
BUM (Build-upmultilayer)	积层多层板	DateCode	周期代码
CCL (Copper-cladlamine)	覆铜板	Ioniccontamination?	离子性污染
AcceptanceQualityLevel(AQL)		允收水平	
HDI (Highdensityinterconnecting)		高密度互连板	
BaseMaterial	基材	Radius	半径
Capacity	生产能力	Diameter	直径
Capability	工艺能力	PPM(PartsPerMillion)	百万分之几
CAM (computer-aidedmanufacturing)		计算机辅助制造	
UnderwritersLaboratoriesInc.		美国保险商实验所	
CAD(computer-aideddesign)		计算机辅助设计	
StatisticalProcessControl	统计过程控制		
Specification	规格，规范	Via	导通孔
Dimension	尺寸	Buried/blindvia	埋/盲孔
Tolerance	公差	Toolinghole	定位孔
Oven	焗炉	Output/throughput	产量

湿流程

PTH(platedthroughhole)	镀通孔 (俗称沉铜)	Acidcleaning	酸性除油
PP(PanelPlating)	板电	Aciddip	酸洗
Patternplating	图电	Pre-dip	预浸
Linewidth	线宽	Alkalinecleaning	碱性除油
Spacing	线隙	Flux	松香
Deburring	去毛刺 (沉铜前磨板)	Hotairleveling	喷锡
Carbontreatment	碳处理	Skipplating	跳镀，漏镀
Track/conductor	导线	Undercut	侧蚀
Aspectratio	深径比	Waterrinsing	水洗
EtchFactor	蚀刻因子	Transportation	行车
BackLightTest	背光测试	Rack	挂架
Pinkring	粉红圈	Maintenance	保养

干流程

Holelocation	孔位	Annularring	孔环
ImageTransfer	图象转移	ComponentSide(C/S)	元件面
Artwork	底片	SolderSide(S/S)	焊接面
Mylar	胶片	MatteSolderMask	哑绿油
Silkscreen/legend/ComponentMark	文字	Holebreakout?	破孔
Fiducialmark	基点，对光点	Scrubbing	磨板
Expose	曝光	Developing	显影

内层制作

页脚内容

精心整理

Corematerial	内层芯板	Thermalpad	散热 PAD
Pre-preg	PP片	Resincontent	树脂含量
KraftPaper	牛皮纸	Brownoxidation	棕化
Layup	排版	BlackOxidation	黑化
Registration	对位	Basematerial	板材
Delamination	分层		
其它			
Wicking	灯芯效应	Holesize	孔径 (尺寸)
Yield	良品率	TouchUp	修理
WarbandTwist	板曲度	SolventTest	溶剂测试
Peeloff	剥离	CompanyLogo	公司标识
TapeTest	胶纸试验	ULMark	UL 标记
Cosmetic	外观	Function	功能
Tin/LeadRatio	锡 / 铅比例	ReliabilityTests	可靠性试验
HoleWallRoughness	孔壁粗糙度	BaseCopperThickness	底铜厚度

PCB 专业英语 (PCBSPECIALENGLISH)

- 1.PCB=PrintedCircuitBoard 电路板
- 2.CAM=Computeraidedmanufacture 计算机辅助
- 3.Pad 焊盘
- 4.Annularring 焊环
- 5.AOI=automaticopticalinspection 自动光学检测
- 6.Chargeoffree 免费
- 7.WIP=workingprocess 在线板
- 8.DCC=documentcontrolcenter 文控中心
- 9.Legend 字符
- 10.CS=ComponentSide=TopSide (顶层) 元件面
- 11.SS=SolderSide=BottomSide (底层) 焊锡面
- 12.GoldPlated 电金 , 镀金
- 13.NickelPlated 电镍 , 镀镍
- 14.ImmersionGold 沉金 = 沉镍金
- 15.CarbonInkPrint 印碳油
- 16.MicrosectionReport 切片报告 , 横切面报告
- 17.X-out=Cross-out 打 "X" 报告
- 18.Panel (客户称) 拼板 , (生产线称) 工作板
- 19.Marking 标记 , UL 标记
- 20.Datecode 生产周期
- 21.Unit 单元 , 单位
- 22.Profile 外形 , 轮廓 <outline>
- 23.ProfileByRouting 锣 (铣) 外形
- 24.WetFilm 湿菲林 , 湿绿油 , 湿膜
- 25.Slot 槽 , 方坑
- 26.BaseMaterial=BaseLaminate 基材 , 板料
- 27.V-out=V-scoreV 形槽
- 28.Finished 成品

精心整理

- 29.Marketing 市场部
- 30.GerberFileGERBER 文件
- 31.ULLOGOUL 标记
- 32.E-Test=ElectricOpen/ShortTest 电子测试
- 33.PO=PurchaseOrder 订单
- 34.Tolerance 公差
- 35.Rigid,FlexibleBoard 刚性 ,软性板
- 36.Boardcut 开料
- 37.Boardbaking 焗板
- 38.Drill 钻孔
- 39.PTH=PlatedThroughHole 镀通孔 ,沉铜
- 40.Panelplating 板面电镀 ,全板电镀
- 41.PhotoImage 图象 ,线路图形
- 42.Patternplating 线路电镀
- 43.Etching 蚀板 ,蚀刻
- 44.SM=SolderMask 防焊 ,阻焊 ,绿油
- 45.SR=SolderResist 防焊 ,阻焊 ,绿油
- 46.Goldfinger 金手指
- 47.Silkscreen 丝印字符
- 48.HAL=HASL=Hotair(Solder)leveling 热风整平喷锡
- 49.Routing 锣板 ,铣板
- 50.Punching 冲板 ,啤板
- 51.FOC=finalqualitychecking 终检 ,最后检查
- 52.FOA=finalqualityaudit 最后稽查 (抽查)
- 53.Shippment 出货
- 54.Flux 松香
- 55.Au 金 ,Cu 铜 ,Ni 镍 ,Pb 铅 ,Tn 锡 ,Tin-lead 锡铅合金
- 56.Leadfree 无铅
- 57.COC=complianceofcertificate 材料证明书
- 58.Microsection=crosssection 微切片 ,横切片
- 59.Chamicalgold 沉镍金
- 60.Mould=punchdie 模具 ,啤模
- 61.MI=manufactureinstruction 制作批示
- 62.QA=qualityassurance 品质保证
- 63.CAD=computeraideddesign 计算机辅助设计
- 64.Drillbitsize 钻咀直径 <diameter>
- 65.Bowandtwist 板弯和板曲
- 66.Hit 击打 ,孔数
- 67.Bonding 邦定 ,点焊
- 68.Testcoupon 测试模块 (科邦)
- 69.Thievingcopper 抢电流铜皮
- 70.Rail-web
- 71.Break-uptab 工艺边
- 72.Breakawaytab 工艺边
- 73.GND=ground 地线 ,大铜皮
- 74.Holeedge 孔边 ,孔内

页脚内容

精心整理

75.Stamphole 邮票孔

76.Template 天坯,型板,钻孔样板(首板)

77.Dryfilm 干菲林,干膜

78.LPI=liquidphotoimage 液态感光=湿绿油

79.Multilayer 多层板

80.SMD=surfacemouteddevice 贴片,表面贴装器件

81.SMT=surfacemoutedtechnology 表面贴装技术

82.Peelablemask=bluegel 蓝胶

83.Toolinghole 工艺孔,管位,定位孔,工具孔

84.Fiducialmask 测光点,光学对位点,对光点,电眼

85.Copperfoil 铜箔

86.Dimension 尺寸

87.Negative 负的,positive 正的

88.Flashgold 闪镀金,镀薄金

89.Engineeringdepartment 工程部

90.Deliverydate 交货期

91.Beveling 斜边

92.Spacing=gap 间隙,气隙,线隙

PCB 的各层定义及描述

为了方便与印制板厂家的技术沟通,提高对 **PCB** 的技术认知一致度,特在此将我司常用 **PCB** 的有关板层特性做简单说明,请爱好者参考此说明进行设计和制造。

PCB 的各层定义及描述:

- 1、TOPLAYER (顶层布线层):设计为顶层铜箔走线。如为单面板则没有该层。
- 2、BOMTTOMLAYER (底层布线层):设计为底层铜箔走线。
- 3、TOP/BOTTOMSOLDER (顶层/底层阻焊绿油层):顶层/底层敷设阻焊绿油,以防止铜箔上锡,保持绝缘。在焊盘、过孔及本层非电气走线处阻焊绿油开窗。焊盘在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即焊盘露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会锡。建议不做设计变动,以保证可焊性;过孔在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即过孔露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会锡。如果设计为防止过孔上锡,不要露铜,则必须将过孔的附加属性SOLDERMASK(阻焊开窗)中的PENTING选项打勾选中,则关闭过孔开窗。另外本层也可单独进行非电气走线,则阻焊绿油相应开窗。如果是在铜箔走线上面,则用于增强走线过电流能力,焊接时加锡处理;如果是在非铜箔走线上面,一般设计用于做标识和特殊字符丝印,可省掉制作字符丝印层。
- 4、TOP/BOTTOMPASTE (顶层/底层锡膏层):该层一般用于贴片元件的SMT回流焊过程时上锡膏,和印制板厂家制板没有关系,导出GERBER时可删除,PCB设计时保持默认即可。
- 5、TOP/BOTTOMOVERLAY (顶层/底层丝印层):设计为各种丝印标识,如元件位号、字符、商标等。
- 6、MECHANICALLAYERS (机械层):设计为PCB机械外形,默认LAYER1为外形层。其它LAYER2/3/4等可作为机械尺寸标注或者特殊用途,如某些板子需要制作导电碳油时可以使用LAYER2/3/4等,但是必须在同层标识清楚该层的用途。
- 7、KEEPOUTLAYER (禁止布线层):设计为禁止布线层,很多设计师也使用做PCB机械外形,如果PCB上同时有KEEPOUT和MECHANICALLAYER1,则主要看这两层的外形完整度,一般以MECHANICALLAYER1为准。建议设计时尽量使用MECHANICALLAYER1作为外形层,如果使用KEEPOUTLAYER作为外形,则不要再使用MECHANICALLAYER1,避免混淆!
- 8、MIDLAYERS (中间信号层):多用于多层板,我司设计很少使用。也可作为特殊用途层,但是必须在同层标识清楚该层的用途。
- 9、INTERNALPLANES (内电层):用于多层板,我司设计没有使用。
- 10、MULTILAYER (通孔层):通孔焊盘层。

精心整理

- 11、DRILLGUIDE （钻孔定位层）：焊盘及过孔的钻孔的中心定位坐标层。
- 12、DRILLDRAWING （钻孔描述层）：焊盘及过孔的钻孔孔径尺寸描述层

PCB 常用英文词汇汇编

Aa

自动光学检查	
Acceptablequalitylevel(AQL)	可接受质量水平
Accuracy	精确度
Activating	活化
Activecarbontreatment	活性炭处理
AfterPressedThickness	压板后之厚度
Alignment	校直，结盟
Annularring	锡圈
Anti-StaticBag	静电胶袋
Apparatus	设备，仪器
Area	面积
Artwork	菲林
ArtworkDrawing	菲林图形
ArtworkFilm	原装菲林
ArtworkModification	菲林修改
ArtworkNo.	菲林编号
Assembly	组装，装配
Axis	轴

Bb

Backplane	背板
Back-up	垫板

精心整理

Baking	烘板
BallGridArray(BGA)	球栅阵列
Bareboard	裸板
BaseCopper	底铜
Basematerial	基材
Bevelling	斜边
BlackOxide	黑氧化
Blindviahole	盲孔
Blistering	起泡 /水泡
BoardCutting	开料
BoardThickness	板厚
Bottomside	底层
Breakawaytab	打断点
Brushing	磨刷
Build-up	积层
Bulletpad	子弹盘
Buriedhole	埋孔
Cc	
C/M(ComponentMarking)	元件字符
Carbonink	碳油
Carrier	带板
Ceramicsubstrate	陶瓷
CertificateofCompliance	合格证书

精心整理

Chamfer	倒角
Chemicalcleaning	化学清洗
Chemicalcorrosion	化学腐蚀
ChipScalePackage(CSP)	晶片比例包装
Circuit	线路
Clearance	间距 / 间隙
Color	颜色
ComponentSide(C/S)	元件面
Compositelayers	复合层
ComputerAidedDesign(CAD)	电脑辅助设计
ComputerAidedManufacturing(CAM)	电脑辅助制作
ComputerNumerialControl(CNC)	数控
Conductor	导体
Conductorwidth/space	导体线宽 / 线隙
Contact	接点
Copperarea	铜面积
Copperclad	铜箔
Copperfoil	铜箔
Copperplating	电镀铜
Corner	角线
Cornermark	板角记号
CornerREG.Hole	角位对位孔
Cracking	裂缝

精心整理

Creasing	皱折
Criteria	规格 ,标准
Crossectionarea	切面
Cu/SnPlating	镀铜锡
Currentefficiency	电流效率
Customer	客户
CustomerDrillingFile	客户钻孔资料
CustomerP/N	客户产品编号
Dd	
D/FRegistrationHole	干菲林对位孔
D/F(DryFilm)	干膜
DateCode	日期代号
Datumhole	基准参考孔
Daughterboard	子板
Deburring	去毛刺
Defect	缺陷
Definition	定义
Delamination	分层
Delay	耽搁
Delivery	交货
Densitomefer	透光度计
Density	密度
Department	部门

精心整理

Description	说明
Designorigin	设计原点
Desmear	去钻污 ,除胶
Dessicant	防潮珠
Developer	显影液 ,显影机
Diamond	钻石
Diazofilm	重氮片
Dielectricbreakdown	介电击穿
Dielectricconstant	介电常数
DielectricThickness	介电层厚度
DielectricVoltageTest	绝缘测试
Dimension	尺寸
Dimensionalstability	尺寸稳定性
Direct/indirect	直接 /间接
Distribution	发放
Documenttype	文件种类
DocumentationControl	文件控制
Doublesidedboard	双面板
Drillbit	钻咀
Drilling	钻孔
DrillingRoughness	钻孔粗糙度
DryFilm	干菲林
DryFilm-Pattern	干膜线路

页脚内容

Dynamic	动态
ECN(EngineeringChangeNotification)	工程更改通知
Effectivedate	有效期
ElectricalTestFixture	电测试针床
Electromigration	漏电
Electroconductivepaste	导电胶
Electroless	无电沉
Electrolesscopper	无电沉铜
ElectrolessNi	无电沉镍
ElectrolessGold/Au	无电沉金
Engineeringdrawing	工程图纸
Entek	有机涂覆
Epoxyglasssubstrate	环氧玻璃基板
Epoxyresin	环氧基树脂
Etch	蚀刻
Etchback	凹蚀
Etching	蚀刻
E-TestMarking	电测试标记
E-Test(ElectricalTest)	电测试
Exposure	曝光
Externallayer	外层

Ee

Ff

Fiducialmark	基准点
--------------	-----

精心整理

Filling	填充
FilmFabrication	菲林制作
FinalQC	最终检查
FinishOverallBoardThickness	成品总板厚度
Fixture	夹具
Flammability	可燃性
FlashGold	薄金
Flexible	易曲的 ,能变形的
Flux	助焊剂
Generalinformation	一般资料
Ghostimage	重影
Glasstransitiontemperature	玻璃化湿度
GoldFinger(G/F)	金手指
Goldenboard	金板
Grid	网格
Groundplane	地线层
HAL(HotAirLeveling)	热风整平
HandRout	手锣
Hardness	硬度
HeatSealed	热密封
HeatShrink-warp	热收缩
Holdingtime	停留时间

页脚内容

Hole	孔
Holebreakout	破坏
Holedensity	孔的密度
HoleDiameter	孔径
Holelocation	孔位
HoleLocationChart	孔位坐标表
HolePositionTolerance	孔位误差
Holesize	孔尺寸
HotAirLeveling(HAL)	热风整平
Humidity	湿度
Identification	标识 ,指标
Image	影像
Imagingtransfer	图形转移
Impedance	阻抗
ImpedanceTest	阻抗测试
Innercopperfoil	内层铜箔
Inspection	检验
InsulationresistanceTest	绝缘测试
InterPlaneSeparation	内层分离
InterleavePaper	隔纸
Internallayer	内层
Internalstress	内应力

精心整理

Ioniccleanliness 离子清洁度

Isolation 孤立

IsolationResistance 绝缘电阻

Item 项目

Kk

KEYboard 按键盘

Keyslot 槽孔

Kraftpaper 牛皮纸

Li

Laminate 板材

LaminateThickness 材料厚度

Laminationvoid 层间空洞

Landlesshole 破孔

Laserplotter 激光绘图机

Laserplotting 激光绘图

Laserviahole 激光穿孔

Layup 层压配本

Lay-upInstruction 压板指示

Legend 字符

LegendWidth 字符宽度

Length 长度

LiftedLands 残铜

LineWidth 线宽

Liquid 液体

精心整理

Location	位置
Logicdiagram	逻辑图形
Logo	唛头 ,标记
Lotsize	批卡
Mm	
Mark	标记
Masterdrawing	菲林图形
MaterialThickness	材料厚度
MaterialType	材料类型
Max.X-out	坏板上限
Max.BoardThicknessAfterPlating	电镀后总板厚度之上限
Measling	白斑
MechDrawingNo.	图纸编号
Mechanicalcleaning	机械清洗
Metal	金属
Method	方法
MI(ManufacturingInstruction)	生产制作指示
Microstrip	微条线
MinConductorCopperThickness	最小线路铜厚
MinHoleWallCopperThickness	最小孔壁铜厚
Min.GoldPlatingThickness	最小金厚
Min.NickelThickness	最小镍厚
Min.Tin-LeadThickness(AfterHAL)	(喷锡后) 最小锡厚

精心整理

Min.AnnularRing	最小环宽
Min.SpacingbetweenLinetoLine	线与线之间的最小距离
Min.SpacingbetweenLinetoPad	线与焊盘之间的最小距离
Min.SpacingbetweenPadtoPad	焊盘与焊盘之间的最小距离
Minimum	最小
Mirroring	镜像
Missing	缺少
ModelNo.	产品名称
Molded	模塑
Motherboard	主板
Moulding	模房
Mountinghole	安装孔
Multilayer	多层板
Multi-layerLaminate	多层板材料
Nn	
Negative	反面的
Netlist	网络表
Network	网络
Nick	缺口
No.ofholes	孔数
No.ofArray/Panel	每个拼板套板数
No.ofPanelperStack	每叠板数
No.ofPanel/Sheet	每张大料拼板数

精心整理

No.ofPcsPerBag	每包数量
No.ofUnit/Array	每套单元数
Normalvalue	标准值
Oo	
Oblong	椭圆形的
Offset	偏移
Open/short	开路 /短路
Optimization(design)	最佳化（设计）
OrganicSolerabilityPeservatives(OSP)	有机保护剂
Originator	原作者
Outercopperfoil	外层铜箔
Outline	外形
Pp	
Packing	包装
Packing	包装
Pad	焊盘
PanelArea	拼板面积
PanelPlatedCrack	板镀缺口
Panelplating	整板电镀
PanelSize	拼板尺寸
PanelSizeAfterOuterlayerCutting	外层切板后拼板尺寸
PanelUtilization	拼板利用率
Passrate	通过率
Passivation	钝化

页脚内容

精心整理

Pattern	线路
PatternInspection	线路检查
Patternplating	图形电镀
PCB(PrintedCircuitBoard)	印制线路板
Peckdrilling	啄钻
Peelstrength	剥离强度
Peelable	可剥性
Peelable	剥离强度
PeelableMask	可脱油
Peeling	剥离
Permanent	永久性
PHvalue	PH 值
Photoplotting	图形输出
Photoviahole	菲林过孔
Photographers	照片靶标
Photoplotler	光绘机
Physical	物理的
Pinhole	销定孔
Pinkring	粉红环
Pinninghole	钻孔管位
Pitch	间距
Placement	放置
PlatedThoughHole(PTH)	沉铜

精心整理

Plating	电镀
PlatingCrack	电镀裂缝
Platingline	电镀线
Platingrack	电镀架
PlatingVoid	电镀针孔
PlugHole	塞孔
Polymer	聚合体
Porosity	孔隙率
Positive	绝对的
Powerplane	电源层
Prepreg	半固化片
Primaryside	首面
Print	印刷
Probepoint	针床测点
Process	工序
Processflow	工序流程
ProductPlanningDept.	生产计划部
Production	生产板
Profile	外形
Profiling	外形加工
ProfilingProcess	外形加工
ProjectNo.	产品编号
PTHThermalSeressTest	PTH 热冲击测试

精心整理

PTH(PlatingThroughHole)	沉铜
Pullaway	拉离
Punch	啤模
Punching	冲切
PunchingMouldDrawing	啤模图形
Qq	
QAAudit	品质审计
QA(QuanlityAssurance)	品质部
QuadPaltPack(QFP)	四边扁平林整器件
Quality	质量
Quantity	数量
Rr	
RawMaterialUtilization	原材料利用率
Recall	回收
Rectifier	整流器
Registermark	对位点
Registration	重合点
Remark	备注
Resin	树脂
ResinRecession	流胶
Resist	抗蚀剂
Resolution	分辨率
Rigid	精密的
Rollercoating	涂覆

精心整理

Roughening	粗化
Roundpad	圆盘
Routing	外形加工 ,铣板
Ss	
S/MMaterial	绿油物料
S/M(SolderMask)	阻焊
Sales	销售
Sample	样板
Samplinginspection	抽样检验
Scalingfactor	缩放比例因素
Scope	范围
Scoring	刻槽
Scratch	划痕
Secondaryside	第二面
SectionCode	组别代号
SectionCodeChange	组别代号更改
Segment	部分 ,片段
Separated	分离
Sequence	顺序
Sets	套
SheetSize	大料尺寸
Shematicdiagram	原理图
Shiny	有光泽的 ,发光的

精心整理

Silkscreen	丝印
Silverfilm	银盐片
Single/double	单层 / 双面
Slot	槽, 坑
Smear	污点
SolderMask	阻焊
Soldermaskonbarecopper(smobc)	裸铜覆盖阻焊膜
Solderside	焊接面
SolderSideC/M	阻焊面字符
SolderSideCir.	焊接面线路
SolderSideCircuit	焊接面
SolderSideS/M	焊接面阻焊
Solderability	可焊性
SolventTest	可溶性测试
Spacing	线距
Specialrequirement	特殊要求
Specification	详细说明, 规范
Spindle	主轴
Split	裂片
Squarepad	方块
Standard	标准值
Static	静态
Stencial	网版

精心整理

Stepdrilling	分布钻
Stepscale	光梯尺
Store	货仓
Supplier	供应商
Supportedhole	支撑点
Surface	表面
Surfacemounttechnology	表面组装技术
Swimming	滑移
Tt	
Tack	堆起
TapeProgramming	铬带制作
TapeTest	胶带测试
TargetHole	目标孔
Teardrop	泪珠
Template	天平
Tenting	封孔
Test	测试
Testcoupon	图样
TestParameter	测试参数
TestPattern	测试孔
TestingVoltage	电压
Thermalshock	热冲击
Thermalstress	热应力

精心整理

Thickness	厚度
TinContent	锡含量
Tin/LeadStripping	退铅锡
Tin-leadplating	电镀铅锡
Tolerance	公差
Topside	板面
Touchup	修理 (执漏)
Training	训练
Transmission	传输线
Transmittance	传送
Trimline	修剪
Ultrasoniccleaning	超声波清洗
Undercut	侧蚀
UnitArrangement	单元排版
UnitLayoutPerPanel	单元拼板图
Uv-blocking	阻挡紫外线
VacunmPack	真空包装
Vacuumlamination	真空压制
V-Cut	V- 坑
ViewFrom ...	观察方向由...
Visual&Warpage	可视性和翘曲度
Visualinspection	目检

页脚内容

精心整理

Voltage	电压
Ww	
W/F(WetFilm)	湿膜
Warp&Twist	翘曲和弯曲
Width	宽度
Wiring	线路